

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2024-046

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨靖	张培培	
电话	021-57850066	021-57850066	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	660,897,505.06	551,752,184.59	19.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,904,090.14	86,805,323.87	-32.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,365,638.74	52,952,332.45	51.77%

经营活动产生的现金流量净额（元）	33,074,091.65	-15,593,344.54	312.10%
基本每股收益（元/股）	0.1895	0.2805	-32.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1895	0.2805	-32.44%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.96%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,201,304,529.34	5,588,589,806.19	-6.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,821,445,162.85	4,188,533,225.02	-8.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王福祥	境内自然人	14.37%	45,032,070.00	33,774,052.00	不适用	0
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	11.96%	37,480,276.00	0	质押	6,260,000.00
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	7.27%	22,788,086.00	0	质押	2,000,000.00
孙慧明	境内自然人	3.23%	10,108,938.00	0	不适用	0
SINYANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	2.94%	9,216,290.00	0	不适用	0
金叶飞	境内自然人	1.69%	5,296,323.00	0	不适用	0
杨燕灵	境内自然人	1.23%	3,854,600.00	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资	境内非国有法人	0.97%	3,052,165.00	0	不适用	0

资基金						
金叶玲	境内自然人	0.96%	2,999,290.00	0	不适用	0
张滕	境内自然人	0.74%	2,317,784.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王福祥、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联股东，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海新晖通过普通证券账户持有 30980276 股，通过信用交易担保证券账户持有 6500000 股，向证券公司出借其持有的部分上海新阳股份股，实际合计持有 37480276 股。孙慧明通过普通证券账户持有 1098939 股，通过信用交易担保证券账户持有 9009999 股，实际合计持有 10108938 股。金叶飞通过普通证券账户持有 3155077 股，通过信用交易担保证券账户持有 2141246 股，实际合计持有 5296323 股。杨燕灵通过普通证券账户持有 53700 股，通过信用交易担保证券账户持有 3800900 股，实际合计持有 3854600 股。金叶玲通过普通证券账户持有 20700 股，通过信用交易担保证券账户持有 2978590 股，实际合计持有 2999290 股。张滕通过普通证券账户持有 5400 股，通过信用交易担保证券账户持有 2312384 股，实际合计持有 2317784 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
上海新晖资产管理有限公司	35,698,176.00	11.39%	2,235,100.00	0.71%	37,480,276.00	11.96%	453,000.00	0.14%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司实现营业收入 6.60 亿元，较去年同期增长 19.78%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 0.80 亿元，同比增长 51.77%。公司半导体业务板块实现营业收入 4.63 亿元，同比增长 36.44%，报告期内首次实现单月销售额破亿元。公司集成电路关键工艺材料系列产品收入快速增长，其中晶圆制造用关键工艺材料实现同比增长超 50%，晶圆制造用电镀液及添加剂系列产品市场份额继续保持快速增长，集成电路制造用清洗系列产品在客户端认证顺利，取得客户订单数量持续增加。涂料业务板块，受行业竞争加剧及涂料产品价格下降等不利因素影响，2024 年上半年公司子公司营业收入持续承压，实现营业收入 1.97 亿元，较去年同期下降 5.24%。为应对市场的挑战和压力，公司子公司积极迎战，适时调整运营管理策略，持续改善运营成本，净利润实现同比 20% 增长。

1、技术创新引领，优势日益凸显

公司坚定不移地贯彻执行以技术为主导，始终坚持自主研发，持续创新；始终坚持面向产业需求，面向前沿技术，面向国内空白，面向进口替代的战略定位。报告期内，面对产业快速发展及下游客户的迭代需求，公司围绕四大核心业务技术，持续加大研发投入，持续创新提升产品性能，为客户提供整体化解决方案。报告期内公司研发投入总额 0.99 亿元，占本期营业收入的比重为 14.99%，同比增长 36.97%。公司研发投入主要用于集成电路制造用光刻胶、先进制程湿法刻蚀液、清洗液、添加剂、化学机械研磨液等研发项目。

在集成电路制造及先进封装材料领域，随着芯片技术的向前发展，推动芯片朝着高性能（大功率、高算力）和轻薄化（体积/面积小）两个方向提升，芯片铜互连成为主流互连工艺技术。电镀系列产品——大马士革工艺、硅通孔工艺（TSV）、凸点工艺（Bumping）广泛应用，来实现金属之间的互联。公司电镀液及其添加剂是实现互联技术的关键工艺材料。经过多年的开发、技术储备以及与客户紧密的联系，报告期内公司电镀液添加剂相关产品销售规模快速提升，与去年同期相比增长超 80%，新产品研发及验证工作也在顺利推进中。

在集成电路制造用清洗液产品方面，28nm 干法蚀刻后清洗液产品已规模化量产，14nm 技术节点干法蚀刻后清洗液也已量产并实现销售，公司干法蚀刻后清洗液产品已经实现 14nm 及以上技术节点全覆盖。本报告期干法蚀刻后清洗液产品销售规模不断扩大，销售额同比增长近 50%，广泛应用于逻辑电路、模拟电路、存储器件等晶圆制造客户。公司报告期内开发的先进制程干法蚀刻清洗液新产品取得突破，研发及验证工作顺利推进，进一步扩展公司清洗液产品的应用市场，助力集成电路关键工艺材料国产替代进程。

在公司原创开发的蚀刻液产品方面，持续纵深开发，紧跟技术更新步伐，做好前瞻性研究和技术储备，针对先进工艺制程技术节点需求的刻蚀/清洗类配方型化学品技术积极布局重点开发，进一步扩大市场应用，引领行业发展。公司清洗类产品的技术及服务优势不断凸显，品牌影响力不断提高，产品营收规模持续提升。

在光刻胶及研磨液两大类产品方面，报告期内研发及市场推广均取得了进展与突破。其中，光刻胶项目研发进展顺利，I 线、KrF 光刻胶产品工艺性能指标不断优化提升，满足客户的工艺需求，在超 20 家客户端进行测试验证，报告期内系列产品销量显著增加。ArF 光刻胶研发顺利推进，浸没式光刻胶目前已有多款产品在国内多家晶圆制造企业开展测试验证工作，部分型号产品已取得良好的测试结果及工艺窗口，技术指标与对标产品比较接近。在研磨液系列产品方面，基础研究、生产工艺、分析开发等方面工作按计划推进，已有成熟的 STI Slurry、Poly slurry, W slurry 系列产品在超过 20 余家客户端测试验证，并不断配合客户研发新产品系列，其中 W slurry 系列产品在客户端验证顺利，具备大规模量产的产品性能。本报告期公司化学机械研磨液已有多款产品通过客户测试，销售量持续攀升。

公司多年来始终如一，坚持自主创新，充分挖掘自身潜力，与产业链上下游协同创新发展，坚定不移地围绕国家被“卡脖子”关键工艺材料产品，围绕公司核心技术持续创新，不断突破，不断提升公司在集成电路制造用关键工艺材料领域的竞争力。

2、半导体业务版图扩张，产能建设日臻完善

半导体行业的蓬勃发展对于科技进步与经济增长具有不可估量的战略价值。随着全球半导体产业的持续增长以及中国大陆新建代工产能的加速扩张，中国大陆半导体市场规模增速将会持续超越全球平均水平，预期将跃居为全球半导体材料市场的领头羊。在此背景下，公司所研发的集成电路制造核心工艺材料产品，顺应市场需求浪潮，具备强劲的市场需求和广阔的发展前景。

公司布局规划的电镀液及添加剂、清洗液、刻蚀液、光刻胶、研磨液等化学品材料产能不断加强，其中上海松江厂区年产能 1.9 万吨扩充目标已完成，合肥第二生产基地建设有原料储罐及自动加料系统、自动称量系统、自动控制系统等自动化和智能化设备设施，一期 1.7 万吨产能已进入试生产阶段。合肥二期规划 5.3 万吨年产能，各类手续正在办理中。本报告期，公司化学品产出超 8,000 吨，其中晶圆制造用化学材料产品产量占比超 70%。为了进一步巩固在国内半导体材料行业的领先地位，公司与上海化学工业区管理委员会、上海化学工业区发展有限公司签订《投资意向协议》，启动位于上海化学工业区的项目建设，规划占地 104 亩，建筑面积 6.5 万平方米，合计产能 6 万吨，该项目主要用于开发光刻胶及配套材料产业化，目前正在办理规划申报建设的各项前期手续。

公司在半导体业务布局和产能建设方面的持续完善，一系列新生产基地陆续建成投产，这将极大促进公司产能的持续扩张与高效释放。因此，公司未来对于市场的供应能力日益增强，不仅可以稳固现有市场地位，也为未来市场需求的增长奠定了坚实的产能基础。

3、践行企业文化，深化半导体气息

新阶段的新阳，始终围绕技术引领、产品引领、市场引领的战略目标，持续创新、创造，打造自身的技术创新优势和未来增长动力，重视体系建设、技术升级及前瞻性研究，努力成为半导体材料行业引领者。

2024 年上半年，公司继续围绕“持续推进半导体气息”管理主题，一方面从企业运营着手，不断实践，不断优化完善管理体系，重点关注市场规划、供应链管理、质量管理、技术创新、安全生产等方面工作，全力落实推进基础数据上线，数据互通、业财融合的系统改造升级任务，实现信息交互同步，优化交叉业务流程，以便满足未来集团战略管控需要，支持集团发展目标。

另一方面公司注重人才团队的培养建设和员工生活。公司结合行业现状及公司发展规划，完善各层级人才梯队建设，开展行业动态讲座，强化师徒带教的人才培养模式。报告期内，公司开展培训超 100 场次，覆盖 500 余人次，为员工搭建职业发展、学习成长的平台，让员工与公司共同成长，持续进步。

在员工生活方面，公司通过持续开展“心温暖”民主对话会活动倾听员工心声，持续开展半导体气息宣传、实践活动，持续提升全员半导体气息意识，组织“传承英雄志 建功新时代”徐州团建活动、开设定期健身项目等活动，关注员工生活、倾听员工心声、激发员工工作和生活热情，提高员工企业文化认同感。

报告期内公司持续践行薪酬证券化，实施了芯征途（三期）员工持股计划及 2024 年股票增值权激励计划，持续与员工共享公司发展红利，不断提升每位员工的幸福感与归属感。未来公司还将坚定不移地推行薪酬证券化的长效激励机制，不断吸引并汇聚行业精英，构建顶尖、稳定、高效的人才团队，为公司的长远发展与可持续繁荣奠定坚实的人才基石。

各项“深化半导体气息”工作的不断开展，使公司的生存成长能力和行业影响力不断增长，使每一位员工的个人品格魅力和职业素养不断提升，最终实现企业竞争力的全面提升。

4、参与产业投资，助力产业发展

长期以来，公司始终深耕集成电路关键工艺材料领域，精心投资布局，助力集成电路全产业链设备、核心原材料等企业的发展，为整个产业链的升级与繁荣贡献力量。

报告期内，公司参与了由长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司持有 90% 股权的子公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司发起设立的合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合伙），助力国家半导体存储产业链的快速发展。同时，为实现我国半导体领域关键工艺材料产业链早日贯通并规模化量产，推动公司光刻胶产品业务的纵深发展，公司以增资方式投资浙江新盈电子材料有限公司。

公司在持续优化集成电路产业链布局的同时，积极赋能集成电路产业链上优质的技术、产品、团队，希望能与公司主营业务形成强大的协同效应，不断拓展并强化公司产品在市场上的竞争力，巩固并扩大行业影响力。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2024 年 8 月 15 日